LIGHT EMITTING DIODE, DEVICE, AND LIGHT SOURCE DEVICE FOR DISPLAY OR COMMUNICATION USING THE SAME

Patent Number: JP2003124508 Publication date: 2003-04-25

Inventor(s): MURAKAMI TETSURO; KURAHASHI TAKANAO; OYAMA SHOICHI; NAKATSU

HIROSHI

Applicant(s): SHARP CORP

Application

Number: JP20010316295 20011015

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L33/00; H01L21/205

EC Classification: Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light emitting diode capable of realizing a layer prevented from absorbing a short wavelength and having a low index of refraction, and having a high index of reflection and increasing the output.

SOLUTION: An AlGaInP system light emitting diode is constituted that a DBR layer 2, an n-type Al0.5 In0.5 P clad layer 3, an Al0.2 Ga0.3 In0.5 P active layer 4, a p-type Al0.5 In0.5 P clad layer 5, and a p-type Al0.9 In0.1 P current diffusion layer 6 are caused to grow, and further an electrode 7 on the p-side and an electrode 8 on the n-side are formed. In which case, a DBR layer 2 formed as a reflection layer on an n-type GaAs substrate 1 is formed such that an Al0.61 Ga0.39 As layer and an n-type ZnSe layer are paired with each other and 10 pairs are formed in a laminated state.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發导 特開2003-124508 (P2003-124508A)

(43)公開日 平成15年4月25日(2003.4.25)

(51) Int.CL*	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
HOIL 33/00		HOIL 33/00	B 5F041
21/205		21/205	5F045

審査請求 京請求 商求項の数8 OL (全 6 四)

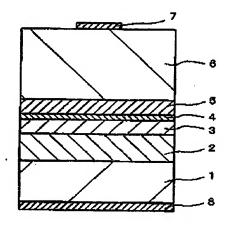
(21)出顧番号	特爾2001-316295(P2001-316295)	(71)出願人	000005049
			シャープ株式会社
(22)出駐日	平成13年10月15日(2001.10.15)		大阪府大阪市阿倍斯区長途町22港22号
		(72) 発明者	村上 哲期
			大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
			ャープ株式会社内
		(72) 発明者	倉് 学尚
			大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
		(74)代理人	
		CHATCHER	
			弁理士 真野 明近 (外1名)
			最終質に続く

(54) 【発明の名称】 発光ダイオード、デバイス、該デバイスを用いた表示または遺信用光源装置

(57)【要約】

【課題】 AIGa!nP系の発光層を有する発光ダイ オードにおいて、短波長に対して吸収がなく、屈折率の 小さい層が実現でき、高反射率が得られるとともに高出 力化が可能となる発光ダイオードを提供する。

【解決手段】 AIGaInP系発光ダイオードは、n 型GaAs基板1上にDBR層2、n型Alasinas Pクラッド層3. Ale., Ga., Ino., P括性層4. p型A!...in...Pクラッド屋5. p型Ga..,in 。...P電流拡散層 6 が成長され、さらに p側電極7、n 側電極8が形成される。ととで、n型GaAs基板1上 に形成される反射層としてのDBR層2は、n型AI e.s.Gae.zeAs層とn型ZnSe層をペアとして10 ペア積層して形成される。



特闘2003-124508

【特許請求の範囲】

【請求項1】 GaAs芸板に格子整合するAlGai n P系の発光層を有する発光ダイオードにおいて、

反射層としてII-VI族の材料を用いたDBR層を育する ことを特徴とする発光ダイオード。

【闘水項2】 AIGaInP系の発光層を有し、該発 光層の下側にDBR層を有する発光ダイオードにおい

前記DBR座はII-VI族の材料圏とAlGaAsまたは AlGalnP系の材料層のペアを積層した構造である 10 ことを特徴とする発光ダイオード。

【論求項3】 AIGaInP系の発光層を有し、該発 光層の上下両側にDBR層を有する発光ダイオードにお

前記下側DBR層はII-VI族の材料層とA!GaAs系 の村料層のペアを積層した構造であり、前記上側DBR 層はA!GaAs系、AlGa!nP系、II-VI族の材 料器とAIGaAS系の村料圏のペアを請磨した構造、 ローVI族の材料層とAIGain P系の材料層のペアを 積層した措造のいずれかの材料であることを特徴とする 20 発光ダイオード。

【語求項4】 AIGaInP系の発光層を有し、該発 光層の上下両側にDBR層を有する発光ダイオードにお bot.

前記下側DBR層はII-VI族の材料層とAIGaInP 系の材料屋のペアを積壓した構造であり、前記上側DB R層はAIGaAs系、AIGaInP系、II-VI族の 材料層とAIGaAs系の材料匣のペアを箱囲した機 造、II-VI族の材料層とAlGalnP系の材料層のペ アを積層した構造のいずれかの材料であることを特徴と 30 する発光ダイオード。

【請求項5】 請求項1乃至4のいずれかに記載の発光 ダイオードにおいて、

前記発光層はダブルヘテロ構造であることを特徴とする 発光ダイオード。

【論求項6】 論求項1乃至5のいずれかに記載の発光 ダイオードにおいて、

前記発光層は電子井戸構造であることを特徴とする発光 ダイオード。

【請求項7】 請求項1乃至6のいずれかに記載の発光 49 ダイオードを樹脂モールド成型したことを特徴とするラ ンプ、チョブLED等のデバイス。

【請求項8】 請求項7記載のデバイスを使用したこと を特徴とする表示または通信用光源装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の層する技術分野】本発明は、発光ダイオード、 デバイス、該デバイスを用いた表示または通信用光源誌 置に関し、さらに詳しくは、AIGaInP系の発光層 と反射層としてII-VI媒の材料を用いたDBR層を有す。50 Onm以下の発光に対して吸収がなく屈折率の小さいII

る高出力の発光ダイオード、デバイス、該デバイズを用 いた表示または通信用光源装置に関する。

[0002]

【従来の技術】AIGaInP系半導体材料を用いた半 導体素子は、GaAs基仮と格子整合が可能であり、可 領領域の発光索子として用いられている。この半導体素 子は、発光ダイオード(LED)として、発光波長55 0~690 nmの範囲で直接遷移型の発光を行う。図6 は、従来のAIGainP系発光ダイオーFの例を示す 模式的断面図である。従来のA!GaInP系発光ダイ オードはn型GaAs基板lからなり、n型GaAs基 板I上に、n型AIGAASDBR層11、n型AII nPクラッド男3、AIGaInP活性圏4、p型AI inPクラッド層5、p型Gae...ine...P電流鉱散層 6が成長され、さらにp側電極7、n側電極8が形成さ れた様式である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】発光ダイオードの出力 向上のため、活性層の下に反射層を形成し基板層への発 光を反射して取り出す方法がある。とのような発光ダイ オードによれば、活性層の下の反射層により基板に吸収 されていた光を取り出すことができるため、反射率が高 いほど出力が向上する。反射圏としてAlens Gaens AS層とAIAS層をペアとして20ペア網磨してAI GaAs系のDBR (distributed bragg reflector: 多層反射膜) 構造を作成すると赤色の発光に対しては9 8%の反射率が得られる。また、AlGalnP層とA IInP層を積層したAIGaInP系のDBR構造で も同様の反射率が得られる。しかし、発光波長を短波長 化していくとA 1組成が小さい層(A 1 G a A s 層また はA1GainP層)は光を吸収するため反射率が低下 する。吸収を選けるようにA!組成を上げると、A!組 成が大きい屋(AIAs層またはAlInP層)との層 折率差が小さくなり、やはり反射率が下がる。570 n mの発光に対してA I ..., Gao., a A S 層とA l A S 層 をペアとして20ペア結婚したDBRの反射率は89% となる。

【0004】本発明の目的はAIGaInP系の発光層 を育する発光ダイオードにおいて、反射層としてZnS e系材料のDBR層を用いることにより、短波長に対し て吸収がなく屈折率の小さい層を実現し、高反射率が得 **られるとともに高出力化が可能となる発光ダイオードを** 提供することである。また、このような発光ダイオード を用いた応用範囲の広いデバイス、該デバイスを用いた 表示または通信用光源装置を提供することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、前記課題を解 決するためになされたもので、AIGainP系の発光 圏を有する発光ダイオードにおいて、反射圏として5.8

-VI族の材料をDBR層に用いることにより、AIGa As 系またはAlGain P系材料との屈折率差が稼げ 高反射率のDBR層ができ、素子の高出力化が可能とな

【0006】本発明の第1の技術手段は、GaAs基板 に格子整合するAIGaInP系の発光層を有する発光 ダイオードにおいて、反射層としてII-VI族の村科を用 いたDBR層を育することを特徴とし、短波長に対して 吸収がなく屈折率が小さいDBR煙を実現することがで きるものである.

【0007】本発明の第2の技衛手段は、AIGaIn P系の発光層を有し、該発光層の下側にDBR層を有す る発光ダイオードにおいて、前記DBR層はII-VI族の 材料層とAIGaAsまたはAIGaInP系の材料層 のペアを精層した構造であることを特徴とし、II-VI族 のDBR層が低屈折率であることにより、AIGAAs またはA!GaInP系の材料との屈折率差が稼げ、短 波長に対して高反射率のDBR層を形成することがで き、発光ダイオードの出力を向上することができる。

【0008】本発明の第3の技術手段は、AIGaIn P系の発光層を育し、該発光層の上下両側にDBR層を 有する発光ダイオードにおいて、前記下側DBR層はII -VI族の材料層とAIGAAS系の材料層のペアを綺層 した構造であり、前型上側DBR層はAIG8AS系、 AlGainP系、II-VI族の材料層とAlGaAs系 の付料層のペアを請屈した構造、エーVI族の材料層とA IGa In P系の材料圏のペアを積層した構造のいずれ かの材料であることを特徴とし、上側DBR層と高反射 率の下側DBR層とによってレゾナントキャビティ標準 が形成され、下側DBR層の反射率が高いことにより発 30 光ダイオードを高出力化することができる。

【0009】本発明の第4の技術手段は、A!Ga!n P系の発光層を育し、該発光層の上下両側にDBR層を 有する発光ダイオードにおいて、前記下側DBR層はエエ -VI族の材料層とAIGaInP系の材料層のペアを請 層した構造であり、前記上側DBR層はAIGaAs 系、AIGaInP系、II-VI族の材料層とAIGaA s系の材料層のペアを領層した構造。II-VI族の材料層 とAlGainP系の材料層のペアを債層した構造のい ずれかの材料であることを特徴とし、上側DBR層と高 反射率の下側DBR層とによってレゾナントキャビティ 模造が形成され、下側DBR層の反射率が高いことによ り発光ダイオードを高出力化することができる。

【0010】本発明の第5の技術手段は、請求項1乃至 4に記載の発光ダイオードにおいて、前記発光層はダブ ルヘテロ構造であることを特徴とし、電子の閉じ込め効 果が大きく、高効率の発光を行うことができる。

【0011】本発明の第6の技術手段は、第1~5の技 衛手段の発光ダイオードにおいて、前記発光層は量子弁 戸構造であるととを特徴とし、質子井戸の深さと幅を変 50 係を示し、図5 (B) はA 1。。。 Ga 。... A s層とA I

えることにより、発光エネルギすなわち発光波長を変化。 させることができ、高出力化することができる。 【0012】本発明の第7の技術手段は、第1~6の技 衛手段の発光ダイオードを樹脂モールド感型したラン

プ、チップLED等のデバイスであることを特徴とし、 高出力の短波長光を利用する広い応用範囲のデバイスを 提供することができる。

【0013】本発明の第8の技術手段は、第7の技術手 段のデバイスを使用した表示装置または通信用装置であ ることを特徴とし、高輝度で視感度が高い表示用ランプ が提供でき、また高SN比の通信用光モジュール等を提 供することができる。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図1 ~5に基づいて説明する。本発明は、AIGaInP系 の発光層を有する発光ダイオードにおいて、反射層とし て580 n m以下の発光に対して吸収がなく屈折率の小 さいZnSe系材料のようなII-VI族の材料をDBR層 に用いることにより、AIGAAS系またはAIGAI nP系との屈折率差が稼げ高反射率のDBR層が得られ る発光ダイオードに関するものである。

【0015】図4は、II-VI族半導体及びGaAsの格 子定数とバンドギャップの関係を示す図である。2nS eはGaAsに格子整合しており、バンドギャップが大 きくAIGaInP系半導体の発光に対して透明であ る。また、2nMgSSe等の液晶でGaAsと格子登 台させることも可能である。したがって、2nSe系の 材料で反射圏を形成すれば、高出力の発光ダイオードが 得ることができるので、視感度の高い表示用ランプ、音 SN比の通信用光モジュール等が実現できる。

【0016】A1GainP系の発光層を有する発光ダ イオードにおいて、発光波長を赤色から黄色、緑色と短 波長化すると、従来のAIGaAs系DBR煙を有する 発光ダイオードでは、短波長化にしたがって吸収が大き くなり反射率が低下する。吸収を小さくするためにはA 1組成を大きくすれば良いが、波長570ヵmの光を吸 収しないためにはA 1組成を0.61以上とする必要が 有り、Ale.s,G8e.ュュAS屈とAlAS屈のペアを復 数ペア綺麗してDBR層を構成すると、両層の差が小さ くなり屈折率差が小さいととでやはり反射率が低下し、 10ペア精層した場合の反射率は53%となる。そこ で、Ale.seGa...,As層と2nSe層のペアを複数 ベア積層してDBR層を構成すれば2nSeはA1As より低屈折率なので、屈折率差が稼げ短波隻に対して高 反射率のDBR層を形成することができる。10ペア請 層した場合の反射率は99%となる。

【0017】図5は、DBR層の反射スペクトルを示す 図で、図5(A)はAla.siGa..seAs層とZnS e層のペアを積層したDBR層の反射率と発光被長の関 10

As 層のペアを慎層したDBR層の反射率と発光波長の関係を示す図である。AlassGassaAs層とZnSe層のペアを慎層したDBR層は、AlassGassa As層とAlas層のペアを積層したDBR層と比べると反射率が高くなり、反射波長幅も広がっていることが分かる。AlGalnPに対しても同様に、AlassGassalnse層のペアを債層してDB

R層を作成し反射率を高くすることができる。 【0018】また、出力向上のため発光座の上下にDBR層を有し、共振器を構成するレゾナントキャビティー構造を採用することが考えられる。レゾナントキャビティー構造では下側のDBR層は高反射率が必要なので、AlassGassasAs層とAlAs層のペアを積層することでは作成できず、本発明の2nSe系のDBR層を用いる必要がある。上側のDBR層の反射率は70%程度でも良いので、AlassGassasAs層とAlAs層のペアでも13ペア以上積層すればビークの反射率は達

【0019】本発明の実験例1~3の発光ダイオードを 図1~3に基づいて説明する。

成できる。しかし、2nSe系のDBR層を用いれば数

ベアで済み、層数を低減することができる。

《実施例1》図1は、実施例1のA1Ga1nP系発光ダイオードを示す模式的断面図である。実施例1のA1GaInP系発光ダイオードは、n型GaAs基級1上にDBR層2、n型A1。,In。,Pクラッド層3、A1。,Ga。,In。,P活性層4、p型A1。,In。,Pクラッド層5、p型Ga。,In。,P含液拡散層6が成長され、さらにp側電極7、n側電極8が形成される。ここで、n型GaAs基板1上に形成される反射層としてのDBR層2は、n型A1。,Ga。,ASの障層とn型2nSeの薄層をペアとして10ペア積層して形成される。

【0020】実縮例1のA1GainP系発光ダイオードによれば、発光波長570nmに対して、DBR層の反射率は99%となり高出力が得られる。従来の発光ダイオードにおける、A1..., Ga..., As層とA1As層をペアとするDBR層ではチョブ光度は40mcdであったが、本実縮例では50mcdと出力が向上した。また。従来例のチョブと本実施例のチョブを樹脂モールドし、ランプ形状にした場合には出力が700μWから40900μWに向上した。このように出力が向上したランブを用いた表示装置は、規認性が向上し、通信機器の送信装置に使用した場合には伝送の長距離化が可能となった。

[0021] 実統例1の構造に限らず、DBR層をAl sin Gae..., Inc., Pの層とZnSeの層のペアを債 置于井戸活性層9は、Alo., Gae..., Inc., Pの DBR層の構成要素をAl GaAs系とする場合 と、Al GaInP系とする場合があるが、その場合、 P型 Alo., Gae..., As層と の DBR層の開新率は若干相違することとなるが、いずれ 50 して13ペア積層して得られる。

の場合でも反射率はほぼ100%となり、同様の効果が得られる。また、GaAsに略格子整合し、発光液長に対して透明なII-VI族材料であれば、ZnSeに限らず機々な材料を用いることができる。ただし、II-VI族材料として例えばZnMgSSeを用いる場合、GaAsと格子整合するように、組成を調整する必要がある。本実証例は結晶成長方法としてMOCVD法(metal orquanc chemical vapordeposition:有機金属気組成長法)を用いたが、MBE法(molecular beam epitaxy:分子線エピタキシャル成長法)によって作談しても同様に出力向上の効果が得られる。

【0022】(実施例2)図2は、実施例2のA1Ga InP系発光ダイオードを示す模式的断面図である。実 施例2のA1GainP系発光ダイオードは、n型Ga As 基板1上にDBR層2. n型A1...Inc...Pクラッド層3、A1GainP多重量子井戸活性層9. p型 A1...Inc...Pクラッド層5、p型Ga...Inc...P 電流拡散層8が成長され、さらにp側電極7、n側電極 8が形成される。ここで、n型GaAs基板1上に形成 される反射層としてのDBR層2は、n型A1...、Ga ...。As 層とn型2nSe層をペアとして10ペア清層 して得られ、またA1GaInP多重量子井戸活性層9 は、A1c...」Gae...、Inc...P井戸層とA1...。GaInc...P時壁層をペアとして4ペア債層して得られる。

【0023】実籍例2の発光ダイオードでは、電子井戸活性層9の効果により高出力となり60mcdとなった。DBR層2の組成は、GaAsに略格子整合し、発光波長に対して透明なエーVI族材料であれば2nSeに、限らず様々な材料を用いることができる。発光層は上記のような電子井戸楼道に限らずシングルへテロ構造やダブルへテロ構造を用いても良い。また、発光波長を様々に変えても良い。結晶成長方法としてはMOCVD法、MBE法が考えられる。

【0024】(実施例3) 図3は、実施例3のA1Galn P系発光ダイオードを示す模式的断面図である。 実施例3のA1Galn P系発光ダイオードは、n型GaAs 芸板1上にn型DBR層2、n型A1e..ine..p クラッド層3. A1Galn P多重量子弁戸活性層9、p型A1e..ine..p Pクラッド層5. p型DBR層1の.p型Ga..,lne..p P電流拡散層6が成長され、さらにp側電極7.n側電極8が形成される。ここで、n型GaAs 基板1上に形成される下側のn型DBR層2は、n型A1e..,Gae..,As層とn型2nSe層をペアとして10ペア積層して得られ、A1GainP多重量子井戸活性層9は、A1e..,Gae..,Ine..,P 井戸層とA1e..,Gae..,Ine..,P 降監層をペアとして4ペア積層して得られ、また上側のp型DBR層10は、p型A1e..。Gae..,As層とp型A1As層をペアとして13ペア積層して得られる。

【0025】東総例3のA1GaInP系発光ダイオードは、発光圧の上下に反射層を有し、2入共振器を構成するレゾナントキャビティー構造を採用している。共振波長は570nmで活性層を定在液の膜の位置に置く。実施例3の発光ダイオードではレゾナントキャビティー構造により高出力となり100mcdとなった。以上の構造に限らず下側のn型DBR層2は、A1e.ziGae.ziIne.iP層のようなA1GaInP系材料と2nSe層をベアとしたり、A1GaAs系材料と2nSe

e.a. In...P層のようなAIGaInP系材料と2nSe層をペアとしたり、AIGaAs系材料と2nSe層をペアとする構造が考えられる。また、上側のp型DBR層10についても、ZnMgSSe、AIGaAs、AIGaInP系材料を用いたり、AIGaAsまたはAIGaInP系材料と2nSe等II-VI族の材料の層をペアとする等様々な構造が考えられる。さらに、発光層9も上記のような量子弁戸構造に限らずシングルヘテロ構造やダブルヘテロ構造を用いても良い。結晶成長方法としてはMOCVD法、MBE法が考えられる。【0026】

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明によればAIGaInP系の発光層を有する発光ダイオードにおいて、反射層として2nSe系材料を含むIIーVI族の材料からなるDBR層を用いることにより短波長に対して吸収がなく屈折率の小さい層が衰現でき高反射率とすることができ、発光ダイオードの高出力化が可能となる。

【0027】以上の説明から明らかなように、詰求項】の発明によれば、GaAs 芸板に格子整合するAlGain P系の発光層を有する発光ダイオードにおいて、反射層がII-VI族の材料を用いたDBR層からなるので、短波長に対して吸収がなく、高反射率の層を形成することができ、発光ダイオードの出力を向上することができる。

【0028】語求項2の発明によれば、AIGaInP系の発光層を有し、該発光層の下側にDBR層を有する発光ダイオードにおいて、前記DBR層はII-VI族の材料層とAIGaAsまたはAIGaInP系の村料層のペアを補層した構造であるので、II-VI族のDBR層が低屈折率であることにより、AIGaAsまたはAIGaInP系の対斜との屈折率差が稼げ、短波長に対して高反射率のDBR層を形成することができ、発光ダイオー40ードの出力を向上することができる。

【9929】請求項3の発明によれば、AIGaInP系の発光度を育し、該発光層の上下両側にDBR層を育する発光ダイオードにおいて、前記下側DBR層はIIーVI族の材料層とAIGAAS系の材料層のヘアを情度した構造であるので、上側DBR層と高反射率の下側DBR層とによってレゾナントキャビティ構造が形成され、下側DBR層の反射率が高いことにより発光ダイオードの出力を向上することができる。

【0030】語求項4の発明によれば、AIGaInP系の完光層を有し、該発光層の上下両側にDBR層を有する完光ダイオードにおいて、前記下側DBR層はII-VI族の材料層とAIGaInP系の材料層のベアを請層した構造であるので、上側DBR層と高反射率の下側DBR層とによってレゾナントキャビティ構造が形成され、下側DBR層の反射率が高いことにより発光ダイオードの出力を向上することができる。

【0031】請求項5の発明によれば、発光層はダブル ヘテロ構造であるので、電子の閉じ込めの効果が大き く、発光効率が向上する。

【0032】詰求項6の発明によれば、発光層は電子券 戸構造であるので、電子井戸の深さと帽を変えることに より、発光エネルギすなわち発光波長を変化させること ができる。

【0033】 請求項7の発明によれば、ランプ、チップ LED等のデバイスが、請求項1~6の発光ダイオード を樹脂モールドすることによって成型されているので、 高出力の短波長光を利用する広い応用範囲のデバイスを 提供することができる。

【0034】詰求項8の発明によれば、表示装置または 通信用装置が、詰求項7のデバイスを使用しているの で、高超度で視感度が高い表示用ランプが提供でき、ま た高SN比の通信用光モジェール等を提供することがで なる

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1による発光ダイオードの断面 図である。

【図2】本発明の実施例2による発光ダイオードの断面 図である。

【図3】本発明の真施例3による発光ダイオードの断面 図である。

【図4】IIーVI族半導体及びG a A s の格子定数とバン ドギャップの関係を示す図である。

【図 5 】 本発明の実施例の発光ダイオードと従来例の発 光ダイオードの D B R 層の反射スペクトルを示す図であ る。

【図6】従来例による発光ダイオードの衡面図である。 【符号の説明】

9 1…GaAs 華板、2…(n型A1,...,Ga,...,As層とn型2nSe層をペアとして10ペア綺麗して得られる) DBR層、3…AIInPクラッド層、4…AIGaInP活性層、5…AIInPクラッド層、6…GaInP電液拡散層、7…p側管極、8…n側管板、9…AIGaInP多宣置子井戸活性層、10…(p型AI・...,Ga・...,As層とp型AIAs層をペアとして13ペア債層して得られる) DBR層、11…AIGaAs系DBR層。